

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국



(10) 국제공개번호
WO 2022/231115 A1

(43) 국제공개일
2022년 11월 3일 (03.11.2022)

- (51) 국제특허분류: *C09G 1/02* (2006.01) *C09K 3/14* (2006.01) 공개: — 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2022/003137
- (22) 국제출원일: 2022년 3월 7일 (07.03.2022)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보: 10-2021-0056801 2021년 4월 30일 (30.04.2021) KR
- (71) 출원인: 주식회사 케이씨텍 (KCTECH CO., LTD.) [KR/KR]; 17599 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30, Gyeonggi-do (KR).
- (72) 발명자: 김정훈 (KIM, Jung Hun); 17548 경기도 안성시 공도읍 장미길 39, 203호, Gyeonggi-do (KR). 황준하 (HWANG, Jun Ha); 17873 경기도 평택시 중앙로 335, 104동 1602호, Gyeonggi-do (KR). 권오성 (KWON, O Seong); 17546 경기도 안성시 대덕면 중앙대학로 157-8, 304호, Gyeonggi-do (KR).
- (74) 대리인: 특허법인 무한 (MUHANN PATENT & LAW FIRM); 06144 서울특별시 강남구 언주로 560, 8층, Seoul (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

WO 2022/231115 A1

(54) Title: POLISHING SLURRY COMPOSITION

(54) 발명의 명칭: 연마 슬러리 조성물

(57) Abstract: The present invention relates to a polishing slurry composition and, to a polishing slurry composition comprising nanoceria abrasive particles and a water-soluble compound comprising an intramolecular hydrophilic group, and further selectively comprising at least one from among an amphoteric compound comprising an intramolecular carboxyl group and amine group, a surface modifier comprising an organic acid, and a pH adjuster.

(57) 요약서: 본 발명은, 연마 슬러리 조성물에 관한 것으로, 나노 세리아 연마입자; 및 분자 내 친수성기를 포함하는 수용성 화합물;을 포함하고, 선택적으로 분자 내 카르복실기 및 아민기를 포함하는 양쪽성 화합물, 유기산을 포함하는 표면 개질제 및 pH 조절제 중 적어도 하나 이상을 더 포함하는, 연마 슬러리 조성물에 관한 것이다.